

반도체·멀티미디어 전담연구소 발족 대우전자(주)

대우전자(대표 배순훈)가 반도체를 중심으로 한 멀티미디어 기반기술을 전문적으로 연구하는 제3연구소를 중앙연구소 내에 설립했다.

이번 중앙연구소 내에 설립된 이 연구소장(소장 손규식 상무)은 현재 (주)대우의 반도체 연구개발 인력 20여명을 발령, 프로젝트별로 3개팀으로 구성됐으며 앞으로 영상기기용 반도체와 멀티미디어용 반도체칩 등의 연구개발에 주력하게 된다.

이를 위해 곧 설립될 미국 뉴저지 첨단기술연구소에 연구개발 인력을 파견해 기술력을 높이는 한편 공동개발 체제를 구축해 나갈 예정이다.

또 현재 디지털 신호처리(DSP)칩의 공동 개발 및 현지공장 설립을 추진하고 있는 프랑스 톰슨사와도 긴밀한 협력관계를 유지해 나갈 방침이다.

무선통신 기능 국내 최 소형 노트북 PC 출시 대우통신(주)

대우통신(대표 류기범)은 국내 최초로 무선통신 기능의 최 소형 노트북 PC를 개발 완료하고

「Solo」(모델명 : CPC-7400)라는 브랜드로 출시했다.

「솔로」는 지난해 약 7만대의 멀티미디어 노트북 PC를 미국 시장에 수출, 「News Week」 「PC Magazine」 등에 최우수제품으로 선정된 바 있는 대우통신이 국내 노트북 PC 시장의 수요확대를 겨냥해 소비자들의 요구사항을 바탕으로 지난해 3월부터 95년 4월까지 약 1년여에 걸쳐 20억원의 개발비를 투입해 개발한 제품이다.

자체 실시한 소비자 조사결과 노트북 PC의 수요확대에 결정적인 요소로 꼽히는 이동성을 강화하기 위해 A4 용지보다 작은 가로 260mm, 세로 193mm에 38mm의 두께를 가진 이 제품은 기존의 노트북 PC가 3~4kg 내외로 한국인들이 사용하기에는 무거웠으나 1.8kg의 무게로 상대적으로 체적이 작은 한국인들이 사용하는 데도 무리가 없도록 하였다.

아울러 PCMCIA 포트 외에 IR(Infrared) 통신포트를 제공함으로써 IR 포트가 장착 되어있는 PC 및 주변장치, OA기기와 무선통신이 가능한 이 제품은 원고를 전송해야 하는 언론 종사자, 작가 등을 비롯해 변호사, 광고제작자 등 전문직 종사자들에게 크게 호평 받을 것으로 보인다.

또한 기존의 노트북 PC들이 최대 2시간 밖에 사용하지 못했던 것에 반해 3.3V의 저전력 소모 회로설계와 95% 이상의 높은 효

율, 배터리 수명 연장 등을 통해 기존 노트북 PC에 비해 사용시간이 2배 이상 늘어난 최대 8시간 까지 사용가능한 「솔로」는 사운드 카드와 고감도 마이크를 내장 녹음과 재생이 가능해 회의나 프리젠테이션 등에도 편리하게 사용할 수 있고 헤드폰잭을 내장 사운드 사용시 헤드폰을 사용할 수 있다.

2004년 매출액 4,300억 목표

미원정보통신(주)

미원정보통신(대표 박태성)은 창립 4주년을 맞아 2004년에 매출액 4,300억원을 달성하고 1,700여명의 전문인력을 확보, 종합정보통신회사로 성장한다는 내용의 장기 비전을 발표했다.

미원정보는 이를 달성하기 위해 그룹지원을 바탕으로 SI(시스템 통합)사업은 물론 자동화·멀티미디어 및 무선통신관련기술을 중점적으로 개발하고 각 사업별로 품목별로 특화하기로 했다.

또 올해중으로 게임소프트웨어·무선통신·인텔리전트빌딩시스템(IBS)분야로 사업영역을 넓혀나가기로 했다.

CD-ROM 노래반주기 개발 (주)비오

음원 및 음원모듈 전문생산업체인 (주)비오(대표 이달수)가 자동음정조절기능을 갖춘 CD롬 영상노래반주기 「CD-Q」(모델명: A-010)를 개발 7월부터 공급에 나선다. 비오는 하얏트호텔 그랜드 볼룸에서 웨이브 테이블 방식의 음원과 CD롬 방식의 음악저장 및 출력기법을 채택해 CD수준의 1,500곡을 4천여컷의 정지화상과 함께 제공하는 「CD-Q」를 발표했다.

16메가바이트 웨이브를 내장한 이 제품은 특히 인공지능회로를 내장, 사용자의 음정 및 음색에 따라 자동으로 음정 및 박자자등을 조절할 수 있고 국내에서는 처음으로 사운드폰트 기법을 이용한 자연음으로 이뤄진 국악기 음색 24종과 다양한 코러스 샘플링을 담고 있다.

비오는 이번 업소용 제품에 이어 오디오CD, 비디오CD, CDG(컴팩트 디스크 그래픽)등 복합기능을 갖춘 가정용 「CD-Q」도 곧 출시할 계획인데 이 제품은 업소용과 달리 동화상을 기본으로 할 계획이다.

1.27mm 베베 코넥터 증산 (주)우영

우영(대표 박기점)이 지난해말 개발을 완료하고 올초부터 시판해 온 무선호출기용 1.27mm 커넥터

의 영업을 대폭강화하고 있다.

우영은 올들어 삼성과 LG정보통신에 무선호출기용 1.27mm 협퍼치 코넥터를 소량공급해왔으나 최근 광역호출기의 등장을 계기로 수요가 대폭적으로 늘고 있는데 힘입어 동제품의 양산설비를 갖추는 한편 인력을 보충, 영업력을 강화하는데 박차를 가하고 있다.

우영은 늘어나는 1.27mm 코넥터의 수요에 부응해 최근 약 4억 원을 들여 자체 개발한 자동조립기와 금형을 이용, 생산량을 현재의 월5백만핀(암·수 각각)에서 월 2천만핀까지 늘릴 계획이다. 또 7월말까지는 텔슨·팬택 등에서 채택하고 있는 듀얼타입 1.27mm 코넥터도 개발을 완료하고 8월부터는 본격적인 영업활동에 나서 관련시장 점유율을 빠르게 높여나간다는 방침이다.

베트남 브라운관 공장 가동 (주)오리온 전기

오리온전기(대표 엄길용)가 베트남 하노이전자와 합작설립한 베트남 현지 브라운관 공장이 최근 완공돼 7월부터 본격가동에 돌입했다.

오리온전기의 베트남공장은 14, 16, 20인치 컬러 텔레비전용 CPT와 14인치 흑백 기종을 우선 월 평균 2만개 수준으로 생산을

시작, 라인 안정화 작업이 완료되는 연말까지는 10만개 규모로 확대하고 내년에는 컬러 21인치와 흑백 12인치 제품도 추가로 생산함으로써 컬러 및 흑백기종 생산량을 각각 100만개와 60만개로 늘릴 계획이다.

오리온과 하노이전자가 3,600만달러와 1,500만달러를 각각 출자, 자본금 5,100백만달러로 출범한 부지 3,600평, 건평 8,600평 규모의 베트남 공장은 생산 설비 도입 등에 모두 1억7천여만달러가 투입됐다.

고속 메모리 탑재를 위한 초박형 BLP 패키지 개발 LG반도체(주)

LG반도체(대표 문정환)는 초고속을 구현할 수 있는 초박형 'BLP(Bottom Leaded Plastic) 패키지'라는 새로운 패키지 기술을 3년간의 연구를 통하여 개발에 성공하는 개가를 올렸다. 이 BLP 패키지는 신뢰성이 높은 완전 봉지형 구조로는 세계에서 가장 얇은 특징을 가지고 있다.

이번에 개발된 패키지는 핀들이 밖으로 전혀 노출되어 있지 않고 바닥에 밀착되어 있는 독창적인 구조로, 지금까지 가장 얇았던 TOSP(Thin Small Outline Package)패키지 두께인 1.27mm의 35% 이상을 줄여 0.82mm 두께로 설계한 신

기술이다.

LG반도체가 개발한 BLP 패키지의 특징은 크게 네가지로 나누어진다.

첫째, 핀들이 밖으로 노출 되지 않는 독창적인 구조이다. 초박형으로 인한 실장 높이의 절감과 더불어 BLP패키지는 인접 패키지와의 전기적 접촉의 우려가 없으므로 PCB보드에 장착할 때 안전 거리를 확보할 필요가 없다. 이러한 잇점으로 인하여 종래의 SOJ (Small Outline j-leaded) 패키지 실장 부피의 65%를 줄일 수 있는 획기적인 기술이며, 적층이 필요한 메모리 카드에서 그 장점이 극대화 될 수 있다.

둘째, 신호선의 길이가 짧아 탁월한 전기적 특성을 가지고 있다. 3GHz까지의 고속 동작을 하는 칩을 탑재할 수 있으며, 이에 수반 될 수 있는 패키지에서의 신호 지연이나 신호간섭 문제를 해결하였다. 이러한 특성을 향후 메모리 시장의 주류가 될 SDRAM과 RDRAM 같은 고속 메모리 개발을 가속화 할 수 있는 전기가 될 것으로 평가된다.

셋째, 두께가 얇고 바닥면의 패드(Pad)를 통해 직접적으로 열 방출이 가능하므로, 추가의 열 방출 장치 없이도 우수한 방열 특성을 보여주고 있다. 이러한 패키지의 열특성은 상대적으로 열발생이 많은 256M 이상의 대용량 메모리에서 널리 채용될 수 있을 것으

로 전망된다.

넷째, BLP 패키지는 외부에 노출된 핀이 없기 때문에 취급시 항상 문제되었던 PIN의 변형이 전혀없다. 또한 이러한 삽입형 핀을 패키지의 바닥면 전체를 활용하여 설치할 수 있어서 핀의 수를 종래의 패키지보다 늘릴 수 있다.

LG 반도체는 지난 5월 미국 전자부품기술학회(ECTC)에서, 'BLP 패키지' 기술 발표와 함께 BLP 적용 제품 전시회를 통해 세계적인 전문가들로부터 기술의 우수성을 인정 받았으며, 국내외에 22건의 특허 출원을 하여 이미 10여건의 등록을 마침으로서 우리나라 패키지 기술을 세계에 과시하였다.

LG 반도체는 확보된 특허와 기술로 자사의 고속 메모리를 박형으로 탑재할 계획이며, Simple Tech사나 VIXEL사 같은 해외 업체와도 연계하여 BLP 패키지의 다양한 활용을 위한 계획도 가지고 있다. 나아가 해외 시장 확대를 위하여 JEDEC과 EIAJ 같은 국제 표준 등록을 위한 절차를 밟고 있다.

레이저 다이오드 개발 LG전자(주)

LG전자(대표 이현조)가 향후 멀티미디어분야에서 최대시장을 형성할 것으로 기대되는 디지털비

디오 디스크(DVD)의 핵심부품인 고성능 자폐발진(Self Pulsation) 적색 레이저 다이오드(LD)를 업계 최초로 개발했다고 발표했다.

LG전자가 93년 6월부터 2년여동안 총 37억원의 연구개발비를 투입해 개발한 이 제품은 레이저빔의 파장이 635나노미터(적색)로 기존비디오CD의 파장(780나노미터, 적외선)에 비해 파장의 크기를 획기적으로 줄여 광디스크의 정보기록밀도를 높일 수 있다. 또 고밀도 영상신호처리가장 큰 문제로 지적돼온 잡음을 크게 감소시켜 DVD의 고성능화 및 저가격화를 앞당길 수 있다고 이 회사는 밝혔다.

이 제품은 또한 2~3개 원자층의 두께를 조절할 수 있는 화합물 반도체 결정성장기술을 적용, 35mA의 낮은 발진개시 전류로 안정적으로 동작시킬 수 있으며 레이저빔의 수평주사각이 8.5도, 광출력은 5mW이며 신호대비 잡음율도 -1백40~-1백25dB로 낮은 우수한 신호특성을 제공한다.

LG전자의 「635나노미터 LD」개발은 핵심부품의 조기확보로 국내 업체들이 보다 빨리 고성능·저가격의 DVD를 상용화하는데 기여할 것으로 평가된다.

삐삐 기술이전 계약 체결

LG정보통신(주)



LG정보통신(대표 정장호)은 1일 서울 여의도 본사에서 인도 타타텔레콤사와 무선호출 기술이전 계약을 체결했다.

LG정보통신은 텔레콤사의 LG정보통신의 트윈스(Twins)와 캐치(Catch)에 대한 기술교육을 실시하고 생산라인 설치를 지원해 정액기술료와 순매출액의 5%를 로열티로 지급받게 된다.

이에 따라 LG정보통신은 이달부터 무선호출기에 대한 기술을 전수해 오는 10월중 생산에 들어갈 예정인데 97년까지 인도 총수요의 15~20%인 30만~45만대가 판매될 것으로 예상하고 있다.

이번에 기술이전을 하는 무선호출 트윈스·캐치는 지난해 LG정보통신이 여성과 신세대층을 겨냥해 선보인 전략제품으로 부드러운 라운드 타입과 밝은 색상을 채택한 패션용 무선호출기다.

한편 LG정보통신이 계약을 체결한 타타 텔레콤사는 전자, 통신, 철강 등 전산업분야를 망라하는 타타그룹의 계열사로 교환기, 전송장비, 무선장비 등을 생산하

고 있는 통신기기 전문제조회사다.

브라질에 브라운관 공장 삼성전관(주)

삼성전관(대표 윤종용)은 브라질 상파울로시 인근에 총 2억달러를 투자, 초현대식 자동화 생산라인을 갖춘 연산 3백50만대 규모의 컬러브라운관 공장을 내년 초착공, 오는 97년 7월부터 본격 가동에 돌입할 계획이라고 18일 발표했다.

삼성전관은 브라질 공장 가동 초기에는 수요가 폭발적으로 늘어나고 있는 14인치 및 20인치 컬러 TV용 CPT생산에 주력하고 라인이 안정화되는 대로 25인치 이상 대형 기종과 고부가가치 제품인 모니터용 CDT도 생산할 계획이다.

이 회사는 브라질공장에서 생산된 제품을 마나우스 지역에 진출해 있는 삼성전자는 물론 현지 컬러 TV업체에 공급하고 주변국가인 아르헨티나 등에도 수출, 이 지역 시장 공략에 박차를 가할 계획이다.

브라운관 업체의 미주시장 진출은 그동안 미국 등 북미지역 공략을 위한 생산 거점 마련 차원에서 멕시코에 집중돼왔으며 최대 상권을 형성하고 있는 브라질에는 세계 2위인 필립스만이 유일하게 진출, 연 5백만대를 생산하고 있

는데 이번에 삼성전관이 가세함에 따라 본격적인 시장 경쟁이 이루어질 전망이다.

삼성전관은 브라질 컬러 브라운관 수요가 올해 6백만대에서 97년에는 7백만대 오는 2000년에는 1천만대에 육박하는 큰 폭으로 예상하고 있다.

게임사업 진출 석정전자(주)

주기관생산업체인 석정전자(대표 박재수)가 게임기 및 관련 SW사업에 참여했다.

석정전자는 올해 MPEG카드 및 VGA 카드사업에 진출한데 이어 21세기 유망사업으로 부각되고 있는 게임기 및 관련 SW사업에도 참여키로 하고 게임사업을 전담할 자회사인 IPLE사를 설립했다고 밝혔다.

자본금이 1억 5,000만원인 IPLE사는 올해 총 25억원을 투입하는 등 연차적으로 대규모 개발비를 투입, 아케이드 게임기 및 관련 SW를 개발하고 이어서 3차원 입체영상(일명 3D)가정용 게임기 등으로 사업분야를 확대, 내수 및 해외시장에 공급할 계획이다.

석정전자는 이미 월드컵축구를 주제로한 하케이드 게임기 및 SW인 「2002 월드컵」개발, 이달 중순부터 본격 공급키로 했다.

이 게임기는 국내 아케이드 게임기로는 처음으로 PC기반에서

규현되는 제품으로 486DX 2급 PC 메인 엔진으로 탑재했다.

특히 기존 아케이드게임기의 그래픽이 2차원 영상에도 해상도가 낮았는데 비해 「2002 월드컵」은 3차원입체영상을 지원, 생동감있는 게임영상을 즐길 수 있도록 설계했다.

TRS 사업 참여 태일정밀

태일정밀(대표 정강환)이 TRS(주파수고용통신)사업에 참여한 다.

태일정밀은 정보통신분야의 사업을 확대강화키 위해 일본 JRC-TRS를 도입, 판매한다고 밝혔다.

JRC-TRS는 유럽규격인 MPT 1327을 수용하는 프로토콜을 채택하고 있으며 3백80MHz대역의 주파수로 개별통화·그룹통화·일제통화·긴급통화·우선순위통화 등의 기능을 지니고 있는 것으로 전해졌다.

출력은 50W이며 채널 간격은 12.5KHz~25KHz이다.

또한 데이터 모뎀이 시스템안에 내장돼 있어 별도의 데이터 별도의 데이터 통신용 모뎀 없이도 직접 데이터통신이 가능하다.

특히 이 시스템은 콘트롤·트래픽 채널을 채택해 장·단 데이터 메시지의 전달이 가능하며 음성통

신 중에도 데이터 통신이 가능하다.

정보통신 사업 참여 한국마벨(주)

한국마벨(대표 조동완)이 정보통신사업에 본격 참여하는 등 사업다각화에 적극 나서고 있다.

한국마벨은 이를 위해 2001년에 年매출액 5천억원달성을 골자로한 중장기발전계획을 마련하고 인천에 연건평 6천평규모의 공장을 건설하는 것을 비롯한 사업구조 조정과 신규사업발굴에 본격적으로 나설 계획이라고 밝혔다.

동사는 우선 정보통신관련사업과 관련해 향후 3년간 1천억원을 투자해 고속모뎀·모니터 등을 개발, 사업기반을 다질 계획이다.

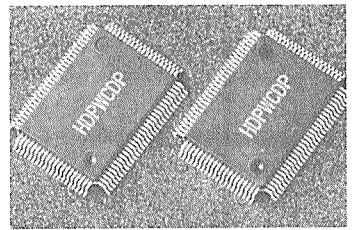
또 사업구조 조정을 위해 경기도 화성·서선공장과 강원도 횡성공장을 매각하고 충북 진천에 연건평 6천평규모의 공장을 내년 6월까지 신축, 국내생산시설을 통합해 신규정보통신 관련제품과 고부가가치의 전자부품을 양산할 계획이다.

이와 함께 부가가치가 낮은 기존 주력제품들은 점진적으로 태국 반봉공장과 중국 청도공장으로 이전할 방침이다.

이 회사의 조동완 대표이사는 「올해 440억원의 매출을 올리는 것을 기점으로 21세기로 도약키

위해 노력하고 있으며 세계 일류의 경쟁력 확보를 위해 경영 및 품질혁신운동을 전개하고 있다」고 말했다.

스마트 파워IC 개발 현대전자산업(주)



현대전자(대표 정몽헌)는 국내 처음으로 소자기능과 저전압의 CMOS제어회로 기능 등을 단일칩으로 구현한 CDP 모터 구동용 스마트파워 IC를 개발했다고 밝혔다.

현대전자가 지난 93년부터 고려대와 공동으로 「일렉트로 21」과제의 하나로 개발을 추진해온 이 제품은 CDP·LDP·HDD·캠코더 등의 핵심부품인 초정밀 소형모터를 구동하는 파워 IC로 3.6~8V까지의 폭넓은 전압범위에서 동작이 가능하고 모터당 최대 8백mA까지 구동할 수 있으며 CMOS(상보성 금속산화막반도체) 기술로 설계, 소비전력을 크게 줄일 수 있는 게 특징이다.

또 공정을 단순화하고 자기격리(Self-Isolation)방식의 LD(Lateral

국·내·업·계·소·식

Diffused)형 전력소자인 MOSFEK (금속산화막 전계효과 트랜지스터) 소자가발을 통해 소자기능 및 제어회로 기능을 하나의 칩에 집적, 칩 면적도 종전보다 25%이상 줄여 원가절감과 가격경쟁력을 크게 향상시켰다.

스마트파워IC는 최근 국내시장에서 연평균 성장률이 25%를 상회할 정도로 급성장하고 있는데 현대는 이 제품이 CDP 등 전자제품뿐 아니라 자동차 전자장 부품등에까지 널리 채용될 것으로 보고 본격적양산에 들어가는 내년부터 연간 1,500만 달러의 수입대체

효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한국후지쯔 - 광주은행경제경영연구소, 다운사이징 프로젝트 협력등 공동사업협정 체결

한국후지쯔

한국후지쯔(대표 이경호)와 광주은행경제연구소(대표 홍명재)는 6월30일 한국후지쯔 본사에서 상호신뢰를 바탕으로 양사의 보유 자원과 기술을 전략적으로 결합하여 공동발전 및 정보산업 발전에

기여하자는 내용의 공동협력 기본협정을 체결했다.

이번 협정을 계기로 앞으로 양사는 상호의 정보기술, 정보혁신 등의 기술이전사업, 시스템 구축 및 판매사업 등에 있어서 상호 협력을 도모해 서로의 이익추구는 물론, 고객들에게 보다 나은 품질의 제품을 제공하게 된다.

구체적인 사업을 들면 S/W의 공동연구개발/판매, 시스템기술의 공동자문/구축/판매, 다운사이징 프로젝트의 공동수행, 상호기술이전, 교육연수 등이다.

회원사 창립일을 축하합니다

회 사 명	창립연월일
두 산 상 사 (주)	'25. 8. 1
대 립 전 자	'86. 8. 1
동 서 전 자 공 업 (주)	81. 8. 1
평 화 전 자 (주)	'91. 8. 1
중 앙 응 용 전 자 상 사	'90. 8. 1
오 리 엔 탈 종 합 전 자 (주)	'74. 8. 2
고 합 상 사 (주)	'71. 8. 2
(주) 카 테 크	'89. 8. 3
보 성 전 자 (주)	'87. 8. 5
한 국 코 아 (주)	'74. 8. 5
경 인 전 자 (주)	'73. 8. 6
삼 주 전 기 (주)	'77. 8.11
(주) 화 승 전 자	'83. 8.12
(주) 크 리 어 전 자	'83. 8.12
프 린 스 상 사	'83. 8. 12

회 사 명	창립연월일
태 성 고 무 화 학 (주)	'73. 8.15
(주) 신 성 전 자	'67. 8.15
정 진 전 자 (주)	'86. 8.16
(주) 컴 픽 스	'87. 8.17
동 광 바 리 안 트 (주)	'88. 8.18
삼 영 전 자 공 업 (주)	'87. 8.20
(주) 한 국 마 벨	'68. 8.20
금 성 알 프 스 전 자 (주)	'66. 8.20
(주) 광 성 전 자	'70. 8.22
충 북 전 자 (주)	'72. 8.23
대 양 씨 키 트	'87. 8.24
(주) 일 우 시 스 템	'79. 8.25
마 포 산 업 전 자 (주)	'87. 8.25
(주) 경 일 엔 지 니 어 링	'87. 8.27
동 서 전 자	'82. 8.27